

## 電子工程助理職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	MPM3114-001v2	電子工程助理	最新版本	略	2020/12/21
V1	MPM3114-001v1	電子工程助理	歷史版本	已被《MPM3114-001v2》取代	2018/12/20

<b>職能基準代碼</b>		MPM3114-001v2			
<b>職能基準名稱 (擇一填寫)</b>		<b>職類</b>			
		<b>職業</b>	電子工程助理		
<b>所屬類別</b>	<b>職類別</b>	製造 / 生產管理	<b>職類別代碼</b>	MPM	
	<b>職業別</b>	電子工程技術員	<b>職業別代碼</b>	3114	
	<b>行業別</b>	製造業 / 未分類其他電子零組件製造業	<b>行業別代碼</b>	C2699	
<b>工作描述</b>		協助電子工程人員完成電子電路製作、樣品組裝、測試及調整。			
<b>基準級別</b>		3			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 ( K=knowledge 知識 )	職能內涵 ( S=skills 技能 )
T1 樣品製作	T1.1 製作 PCBA <sup>【註1】</sup> 樣品	O1.1.1 PCBA 樣品製作紀錄表	P1.1.1 協助電子工程人員蒐集與整理設計文件 <sup>【註2】</sup> 。 P1.1.2 依據電子電路圖與 BOM 表 <sup>【註3】</sup> 完成零件材料準備。 P1.1.3 依據電子電路圖、印刷電路板設計圖及 BOM 表等，完成 PCBA 樣品製作。	3	K01 職業安全與衛生相關規範 K02 電子產品規格 K03 電子電路識圖 K04 電子電路概論 K05 信號與邏輯分析概論 K06 類比與數位邏輯電路概論 K07 嵌入式系統概論 K08 軟體與韌體程式	S01 專業語文溝通能力 S02 電子電路繪圖 S03 電子零件與儀器管理 S04 電源與測試儀器操作 S05 作業系統操作 S06 文書處理能力
T2 樣品組裝、測試及調整	T2.1 樣品製作及組裝		P2.1.1 依據電子電路設計圖、印刷電路板設計圖、韌體程式及產品設計說明書完成樣品製作與組裝。	3	K01 職業安全與衛生相關規範 K02 電子產品規格 K03 電子電路識圖	S01 專業語文溝通能力 S02 電子電路繪圖 S03 電子零件與儀器管理
	T2.2 樣品	O2.2.1	P2.2.1 依據電子工程人員指導，執行樣品測試、調整	3	K04 電子電路概論	S04 電源與測試儀器操作

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 ( K=knowledge 知識 )	職能內涵 ( S=skills 技能 )
	測試及調整	樣品測試及故障紀錄表	<p>及故障檢修。</p> <p>P2.2.2 依據設計文件連結樣品與周邊設備。</p> <p>P2.2.3 協助完成樣品安全標準規格認證。</p>		<p>K05 信號與邏輯分析概論</p> <p>K06 類比與數位邏輯電路概論</p> <p>K07 嵌入式系統概論</p> <p>K08 軟體與韌體程式</p> <p>K09 程式偵錯、修改及版本維護</p> <p>K10 安全標準規格相關認證</p> <p>K11 周邊硬體設備</p>	<p>S05 作業系統操作</p> <p>S06 文書處理能力</p> <p>S07 電子電路組裝與測試</p> <p>S08 設備清潔保養</p> <p>S09 周邊硬體設備安裝</p> <p>S10 程式軟體測試</p>

#### 職能內涵 ( A=attitude 態度 )

- A01 親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。
- A02 持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。
- A03 自信心：在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時，相信自己有足夠的能力去應付；面對他人反對意見時，能獨自站穩自己的立場。
- A04 壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。
- A05 謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。
- A06 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

#### 說明與補充事項

- 建議擔任此職類 / 職業之學歷 / 經驗 / 或能力條件：
  - 高中 ( 職 ) 以上畢業。
- 其他補充說明：
  - 【註 1】PCBA：printed circuit board assembly ( 組裝後的電路板 )。
  - 【註 2】設計文件：包含電子電路設計圖、印刷電路板設計圖、韌體程式、產品設計說明書、樣品測試驗證報告等。
  - 【註 3】BOM 表：bill of material ( 零件表 )。
  -